

826634-4 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

TE 内部编号 826634-4

PCB Mount Header, Right Angle, Board-to-Board, 8 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Breakaway, AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 8

行数: 2

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 连接器系统 | 板对板 |
| 接头类型 | 分离 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

结构特性

| | |
|-----------|----|
| 板对板配置 | 垂直 |
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| 位数 | 8 |
| 行数 | 2 |
| PCB 安装方向 | 直角 |

电气特征

| | |
|------------|----------|
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ |
| 介质耐压 (最大值) | 750 Vrms |

主体特性

| | |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 绿色 |
|--------|----|

接触件特性

| | |
|--------|-----------------|
| 接合方柱尺寸 | .63 mm[.025 in] |
|--------|-----------------|

| | |
|------------------|-----------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 3 μm |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .8 μm[31.5 μin] |
| 端子形状和构造 | 正方形 |
| 端子底板材料 | 镍 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 镀金或钯镍打底镀金 |
| 端子类型 | 插针 |
| 端子额定电流（最大值） | 5 A |

端接特性

| | |
|-------------|-----------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .63 mm[.025 in] |
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.2 mm[.126 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |

机械附件

| | |
|----------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准 | 不带 |
| PCB 安装对准 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 不带 |

壳体特性

| | |
|---------|----------------|
| 外壳材料 | PBT |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

| | |
|------------|------------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in] |
| 行间距 | 2.54 mm[.1 in] |

使用环境

| | |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 标准 |
| 工作温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |

操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装数量 | 400 |
| 封装方法 | Box |

产品合规性

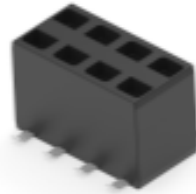
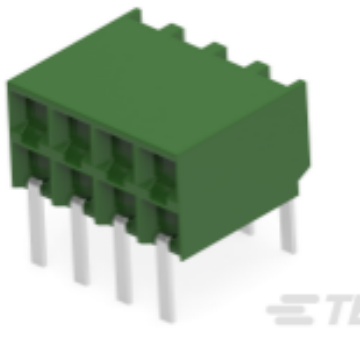
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

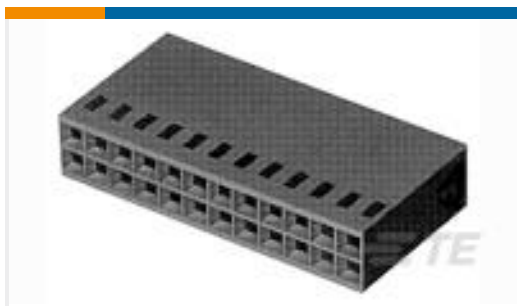
| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 265°C |

产品合规免责声明

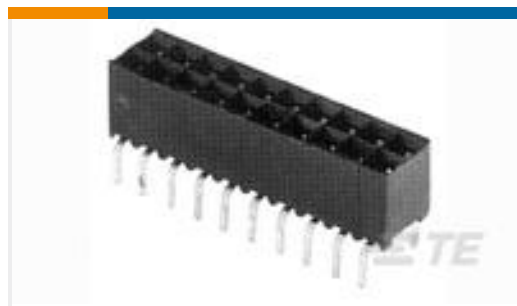
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

| | | | |
|---|---|---|---|
|  <p>TE 产品编号 215309-4 2X4P HV100 REC CON. TE, 8.5MM</p> |  <p>TE 产品编号 969973-4 2x4P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER</p> |  <p>TE 产品编号 215307-4 2X4P HV100 REC CON. TE, 7.0MM</p> |  <p>TE 产品编号 216604-4 2X 4P HV190FEDERLEI</p> |
|---|---|---|---|

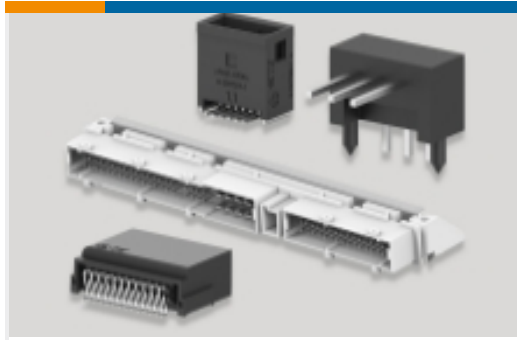


TE 产品编号 925367-4
MOD 4 REC.HSG 2X04P



TE 产品编号 829264-4
2X 4P HV100 REC CON.B/TE, 6.2,NO
KINK

该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers



PCB 板端连接器及母端(4353)



线到板连接器组件和护套(5)



连接器盖帽(1)



连接器硬件(2)



连接器端子(64)

客户还购买了



TE 产品编号413990-2
STR JACK,SMB,PCB



TE 产品编号1-640456-4
14P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR



TE 产品编号5177986-3
0.8FH,P05H.5,080,08/Sn,TR,SC



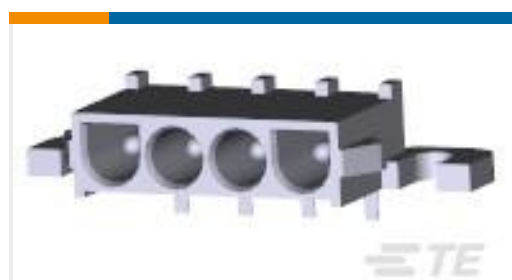
TE 产品编号T4110512041-000
M12 F, 4P GOLD D_CODE S
SHIELDED PG9



TE 产品编号5-794620-4
24P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF



TE 产品编号826925-5
5P MOD2 STIFT LEI



TE 产品编号1-350944-0
04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号3-1415379-1
RT33LA24



文档

产品图纸

[AMPMODU MOD II PIN HEADER](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_826634-4_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_826634-4_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_826634-4_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本